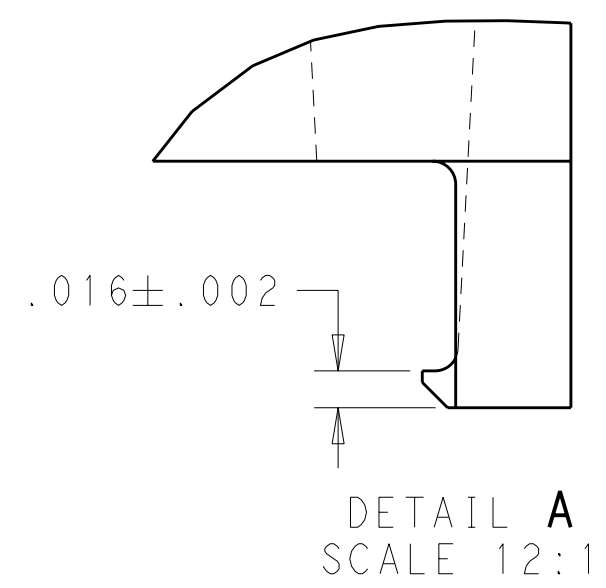
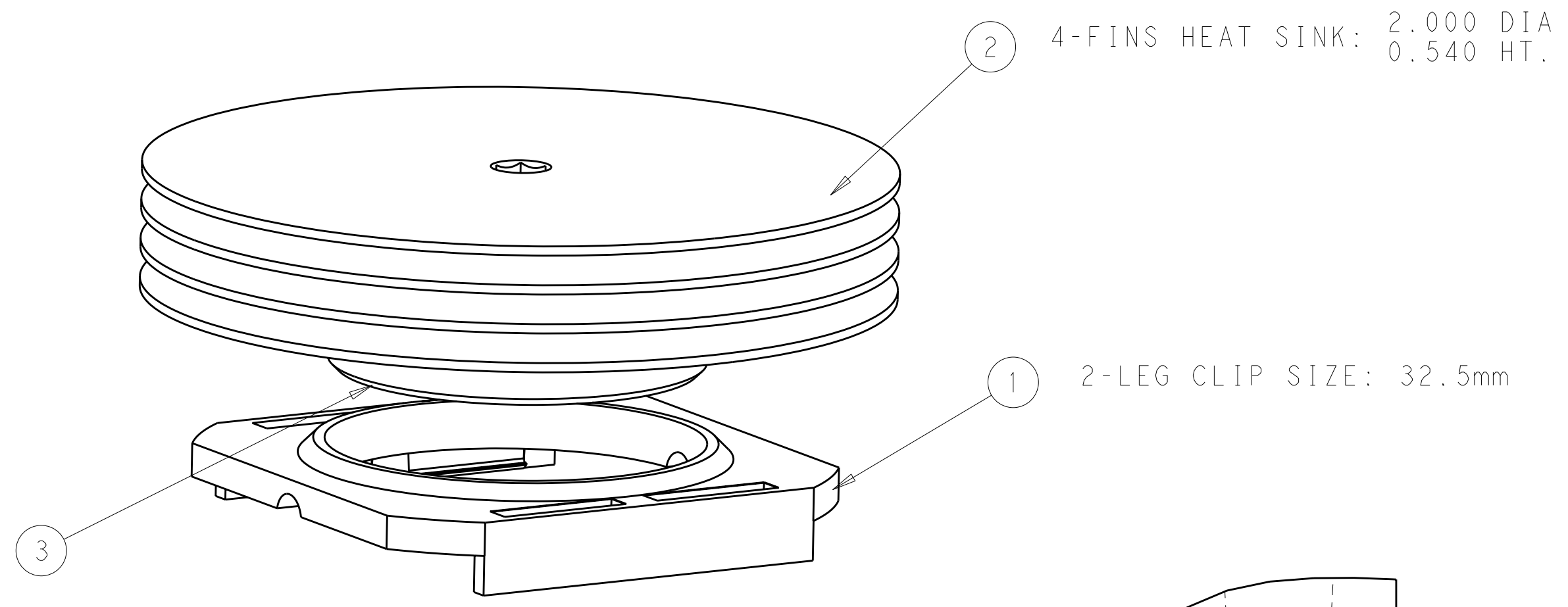


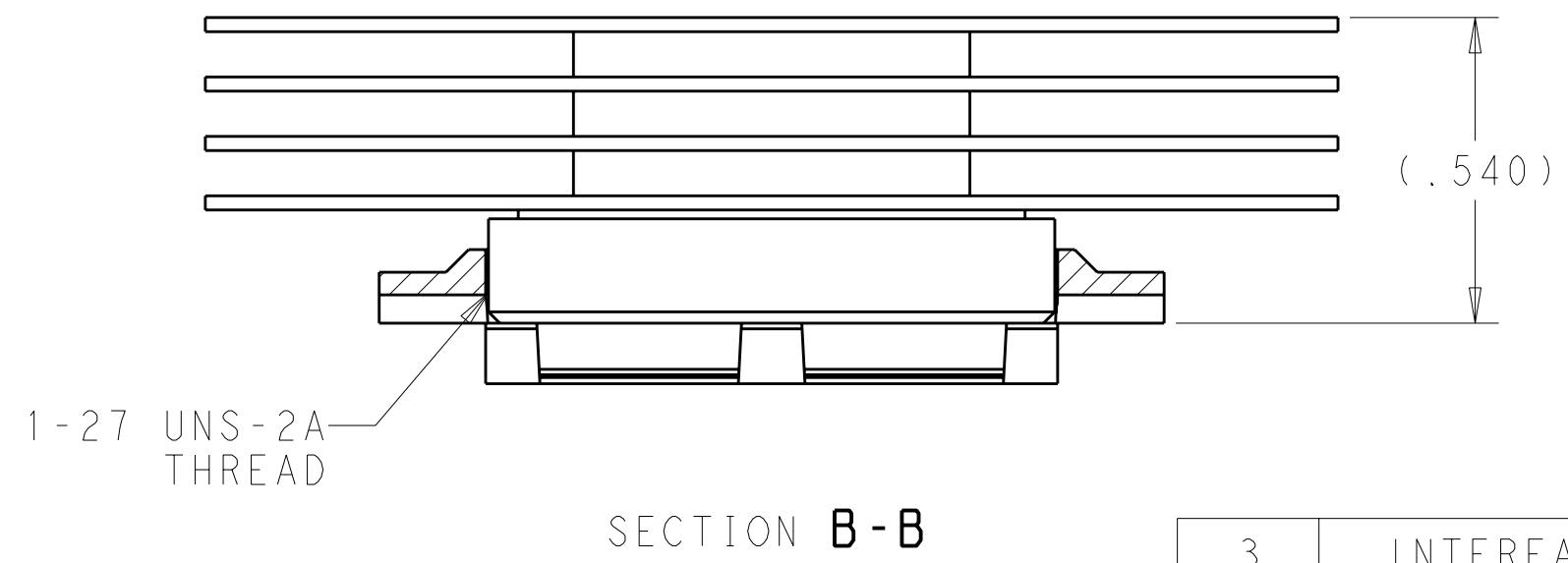
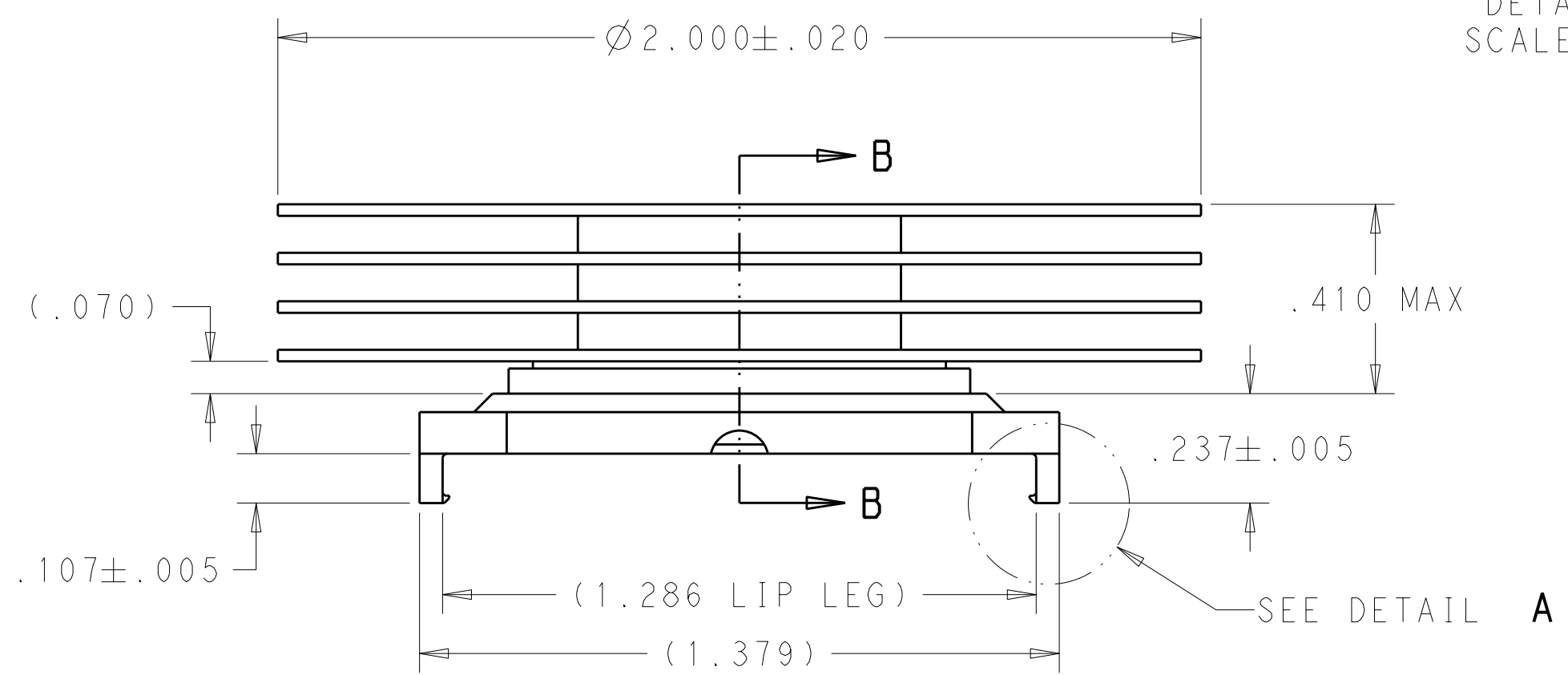
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20  
 © COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
	B	REVISED/REDRAWN PER ECO-09-020027	16OCT2009	DH	JE		



NOTE:

- MATERIAL:  
HEAT SINK: ALUM. (BLACK ANODIZED)  
CLIP: BLACK PEI (UL94-VO)
- BEFORE THE HEATSINK APPLICATION, THE USER SHOULD IDENTIFY THE SPECIFICATION OF MAXIMUM LOAD ON THE BGA PACKAGE.  
  
HEAT SINK TORQUE SPECIFICATIONS CONVERTED TO FORCE.  
  
BARE DIE PACKAGE:  
2.0 INCH-LB TORQUE=8.1 LBS FORCE  
2.5 INCH-LB TROQUE=10.1 LBS FORCE  
  
FULL SIZE LID PACKAGE:  
2.0 INCH-LB TORQUE=6.9 LBS FORCE  
2.5 INCH-LB TROQUE=8.7 LBS FORCE
- REMOVE CLIP WITH REMOVAL TOOL P/N: 1542616-1
- RoHS COMPLIANT AND CERTIFIED



ITEM	DESCRIPTION	QTY
3	INTERFACE	1
2	HEAT SINK	1
1	MOUNTING CLIP	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN D. HUMBERT 16OCT2009	Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES		CHK J. EABY 16OCT2009	NAME 32.5mm HEATSINK ASSEMBLY (HTS512-U)	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±. 1 PLC ±.1 2 PLC ±.02 3 PLC ±.005 4 PLC ±.0005 ANGLES ±. FINISH		APVD J. EABY 16SEP2009	SIZE A200779	
MATERIAL SEE NOTE		PRODUCT SPEC -	DRAWING NO C-2-1542006-1	
SEE NOTE		APPLICATION SPEC -	RESTRICTED TO -	
SEE NOTE		WEIGHT -	SCALE 3:1 SHEET 1 OF 1 REV B	
CUSTOMER DRAWING				

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9